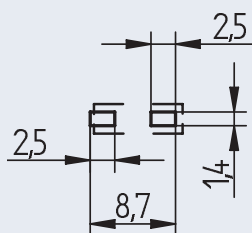


Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden

Empfohlene Maße für die Lötflächen



SMD-Leiterplattenklemme Nano mit Steckkontakten und Kontaktöffnungsfunktion

1-polig - 46.141.2001-0

Direktes Stecken von eindrängigen Leitern

Kontaktöffnungsfunktion - zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte oberseitig

Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

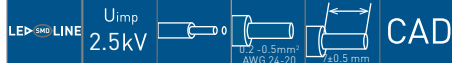
Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 610760-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß
Kontaktwerkstoff: CuNi
Kontaktoberfläche: feuerverzinkt

Zur Betätigung der Kontaktöffnungsfunktion, empfehlen wir den Einsatz unseres Werkzeugs 46.141.U801-0.

Daten zur Verpackung 46.141.2001-0

Gewicht SMD-Klemme	0.2 g
Anzahl pro Spule	4.050
Spulendurchmesser Gurtverpackung	381 mm - 15"
Gewicht pro Spule	1.07 kg
Anzahl an Spulen pro Karton	18
Anzahl an SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton	72.900
Gewicht pro Karton	15.4 kg
Abmessungen Karton (LxBxH)	400 x 405 x 415 mm



Zubehör:

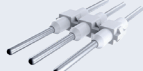
SMD Nano-Flex-B2B-Verbinder. Zur Verbindung von Leiterplatten. Die Verbinder sind in 21 mm Länge erhältlich.



46.141.U701-0



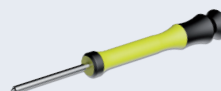
46.142.U701-0



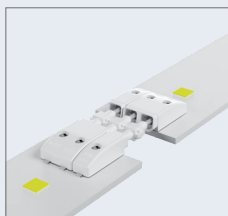
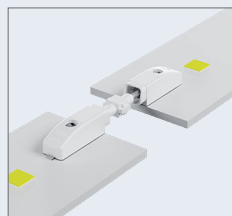
46.143.U701-0

Werkzeug zur Kontaktöffnung

Zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter



46.141.U801-0



Anschlussdaten

Anschluss technik	Steckkontakt
Eindrähtige Leiter	0.2 - 0.5 mm ² , AWG 24-20
Abisolierlänge	7 ± 0.5 mm
Leitereinführung	0
Leiterlösefunktion mittels	Werkzeug zur Kontaktöffnung

Auszugskraft nach DN 60999-1

0.2 mm ²	min. 10 N
0.34 mm ²	min. 15 N
0.5 mm ²	min. 20 N
0.75 mm ²	min. 30 N
Einsteckkraft	max. 10 N

Geometrische Daten

Rastermaß	3 mm / 0.12 inch
Breite	3 mm / 0.12 inch
Höhe	2.7 mm / 0.11 inch
Tiefe	9.3 mm / 0.37 inch
Spulendurchmesser Gurtverpackung	330 mm (13")
Gurtbreite	16 mm
Pitchabstand	8 mm
Verpackungseinheit Tape-and-Reel	2.800
Verpackungseinheit Karton	50.400 (18 Spulen)

Werkstoffdaten

Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	PPA, weiß
PTI	600
Entflammbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktwerkstoff	CuNi
Kontaktoberfläche	feuerverzinkt

Mechanische Daten

Montageposition	Leiterplatte oberseitig
Befestigungsart	Bleifreies Reflow-Löten

Temperaturbedingungen

Grenztemperaturbereich	-70 °C bis + 150 °C
Umgebungstemperatur	-70 °C bis + 125 °C
T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12	120° C

Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1)

Bemessungsspannung (III / 3)	63 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	2.5 kV
Bemessungsspannung (III / 2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	2.5 kV
Bemessungsspannung (II / 2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (II / 2)	2.5 kV
Bemessungsstrom	3 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1977 / CSA-C22.2 No. 182.3

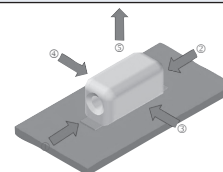
Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	USR 9 A, AWG 24 -18 CNR 6 A, AWG 24 -20 CNR 9 A, AWG 18

Länderspezifische Zulassungen Zertifikate

VDE / ENEC	EN IEC60947-7-4 Ausweis-Nr.: 40040866
cURus	UL 1977 / CSA-C22.2 No. 182.3 File no.: E-365006

Scherkräfte nach IEC 62137-1-2.

Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung.

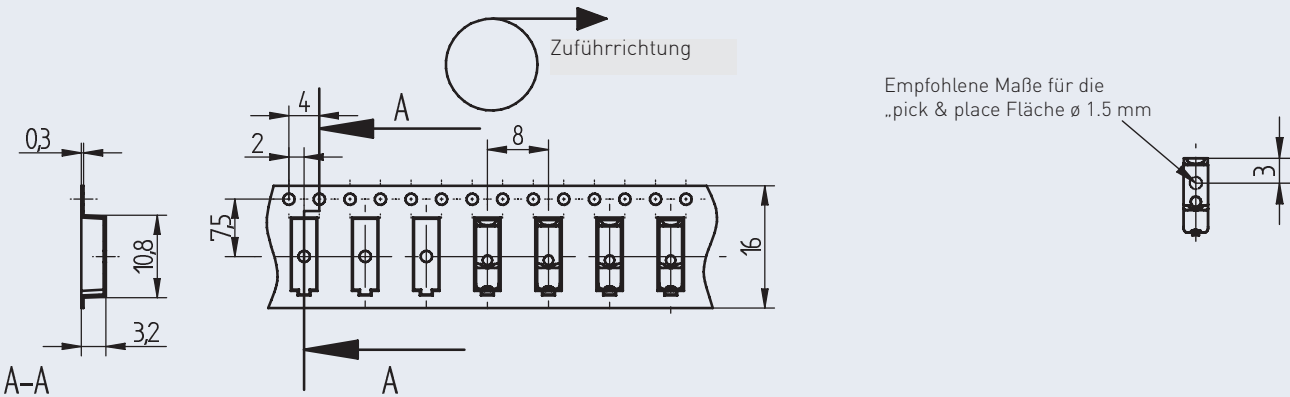


Richtung 1 + 2 Scherkraft längs	40 N
Richtung 3 + 4 Scherkraft quer	15 N
Richtung 5 Abzugskraft	15 N

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



Lagerdauer	Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden.
max. zulässige Reflowvorgänge	3
Lötprofil	Reflow-Profil (bleifreies Löten): The graph shows a reflow profile with the following parameters: - Heating rate: 1.5 - 2.5 K/s - Preheat temperature: $T_p: 150\text{ °C} - 180\text{ °C}$ - Preheat time: $t_p: 60 - 120\text{ sec}$ - Peak temperature: $T_{max} = 260\text{ °C}$ - Peak time: $t_{max} < 10\text{ sec}$ - Cooling rate: 2 - 3.5 K/s - Minimum temperature: $T_L \geq 230\text{ °C}$ - Minimum time: $t_L: 20 - 60\text{ sec}$
Lötbarkeit	Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft
Montageverfahren	SMD, nach Zeichnung
Materialstärke SMD-Schablone	100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150 µm)